

産業タイムズ社 泉谷社長講話

日時;平成25年4月30日

場所;日本精密電子(株)

今後の半導体設備投資動向;メディカル、シェルガス関連

※IT関係は良くて10%で、今後は2~5%程度。

2016年のオリンピックイヤーが鍵

勝ち組;TSMC

負け組;富士通、ルネサス

電装が富士通の岩手工場を買ったが、オペレーターが優秀ではない。

当面開発は期待できず、マイコンの生産を続けている。

2年後にはパワー半導体。

LG;液晶チャンピオン、サムソンを抜いた。

ノートパソコン; 2億台 ⇒ 2015年 1.5億台に減少

液晶はCRTの置き換わり、発展の余地が無い

半導体のスマホ、タブレット用途は2~3年でピークアウト

↳(現在6~6.5億台)

↳(スマホ;9億台 タブレット;12億台)

半導体市場の伸びが無くなったため

1)コストダウン

A. 450ウェハー 3次元立体構造

D-RAM ⇒ M-RAM(消費電力がD-RAM1の1/100)

・サムソンのギャラクシーのスマホはひどい。充電を頻繁にする必要がある。

B. ファブレス --- ファウンドリーの活用

統合構造 ⇒ 水平分業

前工程 ----- UMC, TSMC

後工程

テストング

<半導体ランキング>

1位 インテル

2位 サムソン

3位 クアルコム(Qualcomm) ファブレスメーカーが3位に入った!

TSMCはクアルコムの生産を受託しており、設備投資を増やしている。

TSMCの将来のライバルはサムソン。サムソンはファウンドリー化を目指している。

クアルコムは自前の工場をカ州に作る。

2) 450mm ウェハ採用

対応できるのは、インテル、サムソン、TSMC、(東芝)

5000億円/棟

450mm ウェハはコストダウンが目的であり、半導体の量産が目的ではない。
量的には飽和してきている。

5年後、450mmが占める割合は5~10%程度。300mmが相変わらず主流。

3) プロセスコストの低減(装置コスト)

NAND 東芝;600工程 サムソン;350工程

⇒ 装置の革新、プロセスの革新

◆シェールガス革命

知財権

<米国>

- ①大河の周辺にシェールガスが存在。
- ②米国は地権者がガスを掘る権利を持っている。⇒ 盛んに掘っている。
(他の国では地下は国が権利を持っており、機動性が欠如)
- ③インフラがある(道路等)

シェールガスによる電力生産コスト;¥6/kW

シェールガスの成分中にはブタジエン、ヘリウムが無い。

※中国は現在のチベット地域に大量のシェールガスが埋蔵されているが、
インフラが全く無い。インフラ整備に多額の費用と時間がかかる(20年?)。

<シェールガス関連ビジネス>

- ・掘場製作所;米国キャメロン社を買収。シェールガスの分析事業。
- ・新日鉄住金;鋼管
- ・小松、日立建機;重機
- ・荏原製作所;LNGプラント ポンプ

◆将来性の高い半導体事業(知的財産防衛の為全て日本国内の工場で生産対応)

- ・日亜;LED(発光ダイオード)
- ・ソニー;C-MOSセンサー
- ・三菱電機;IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)
- ・東芝;M-RAM

◆泉谷社長の株価・為替相場予測

2013年12月末; 為替 \$=¥120 株価 ¥18,000